



Steckverbinder > PCB-Steckverbinder > Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbinder > Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbindersätze und -gehäuse



Produkttyp des Steckverbinders: **Gehäuse**

Steckverbinder- und Gehäusotyp: **Buchse**

Steckverbindersystem: **Draht-an-Leiterplatte**

Anzahl von Positionen: **11**

Raster: **2.54 mm [.1 in]**

Eigenschaften

Produktmerkmale

Produkttyp des Steckverbinders	Gehäuse
Steckverbinder- und Gehäusotyp	Buchse
Steckverbindersystem	Draht-an-Leiterplatte
Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an	Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

Anzahl von Positionen	11
Zeilenanzahl	1

Elektrische Kennwerte

Anschlusswiderstand	12 mΩ
Isolierwiderstand	5000 MΩ
Spannungsfestigkeit (max.)	750 V
Arbeitsspannung	250 VAC

Kontaktmerkmale

Kontaktaufbau	Verbindungsuffe
Kontakttyp	Stecksockel
Kontaktmaterial	Beryllium-Kupfer
Kontakt-nennstrom (max.)	3 A

Klemmenmerkmale

Anschlussmethode für Leitungen und Kabel	Crimpverbindung
--	-----------------

Montage und Anschlusstechnik

Zugentlastung	Ohne
Typ der Gegensteckarretierung	Einrastarretierung
Gegensteckarretierung	Mit

Gehäusemerkmale

Gehäuseeingangskonfiguration	Beide Enden geschlossen
Gehäusematerial	Nylon – GF, Nylon – GF
Raster	2.54 mm [.1 in]
Gehäusefarbe	Schwarz

Abmessungen

Steckverbinderlänge	27.94 mm [1.1 in]
Steckverbinderhöhe	4.62 mm [.182 in]

Verwendungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich	-65 – 105 °C [-85 – 221 °F]
---------------------------	-----------------------------

Betrieb/Anwendung

Stromkreis Anwendung	Signal
----------------------	--------

Industriestandards

Bezugswert des Glühdrahts	Standardteil – ohne Glühdraht
Zugelassene Standards	CSA LR7189, UL E28476
UL-Brandschutzklasse	UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

Verpackungsmenge	1
Verpackungsmethode	Paket

Produkt-Compliance

[Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>](#)

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	

Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2023
(233)

Kandidatenliste deklariert bezüglich: JAN
2023 (233)

Enthält keine SVHC

Halogengehalt

BFR/CFR/PVC frei, allerdings Br/Cl >900
ppm aus anderen Quellen

Lötfähigkeit

Für Lötfähigkeit nicht zutreffend

Produktkonformitäts-Disclaimer

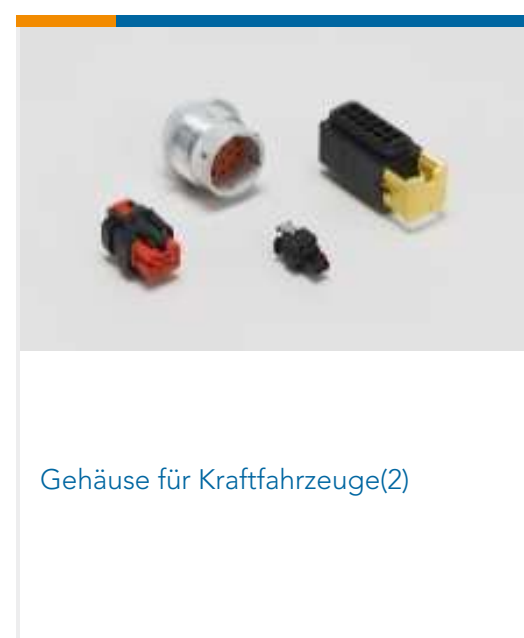
Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

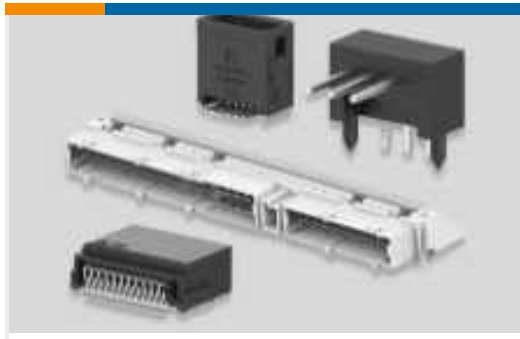
Kompatible Teile





Auch serienmäßig | AMPMODU IV/V





Leiterplattenstiftleisten und -buchsen (939)



Montage von Leiterplatten-Steckverbindern(1)



Rechteckige Standardsteckverbinder(8)



Rechteckige Steckverbindergehäuse(5)



Steckverbindergehäuse für Backplanes (1)



Zugentlastung für Leiterplatten-Steckverbinder(3)

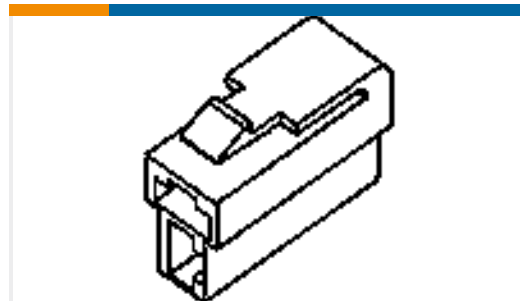
Kunden kauften auch diese Produkte



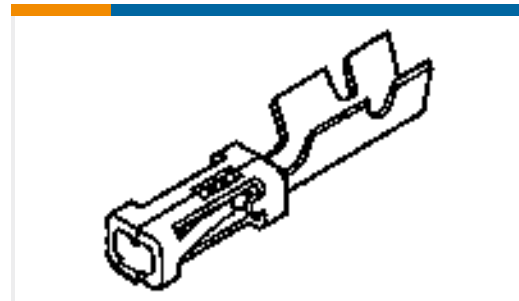
TE Teilnr.:4-640441-0
10P MTA100 CONN ASSY WHT



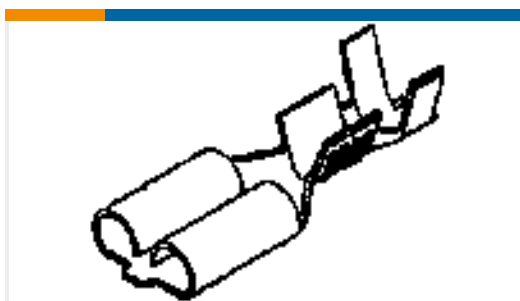
TE Teilnr.:1625999-3
HSC100 10R 5%



TE Teilnr.:172130-1
FF 250 REC HSG 2P NYLON NAT



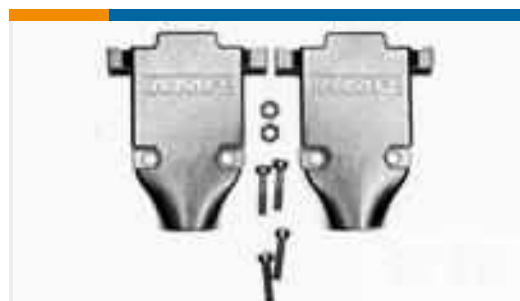
TE Teilnr.:6-87756-2
MOD IV RECP PLTD 15 DPLX LF



TE Teilnr.:170258-2
FF 250 REC 14-12AWG TPBR REREELING



TE Teilnr.:1-2176342-6
CRGCQ 0805 330R 5%



TE Teilnr.:5748678-3
2 PC PLST CBL CLMP KIT



TE Teilnr.:59803-1
MAINTENANCE TOOL



TE Teilnr.:2-102241-0
22 MODIV HSG COMP SR .100 POL

Dokumente



Produktzeichnungen

[11 MODIV HSG COMP SR .100 POL](#)

Englisch

CAD-Dateien

[3D PDF](#)

3D

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_102241-9_AE.2d_dxf.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_102241-9_AE.3d_igs.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_102241-9_AE.3d_stp.zip](#)

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.

Datenblätter/ Katalogseiten

[AMPMODU_INTERCONNECTION_SYSTEM_SECTION5_CONT](#)

Englisch

Produktspezifikationen

[Produktspezifikation](#)

Englisch